

COMPANY RESEARCH AND ANALYSIS REPORT

|| 企業調査レポート ||

筑波精工

6596 東証 TOKYO PRO Market

[企業情報はこちら >>>](#)

2026年6月12日(金)

執筆：客員アナリスト

寺島 昇

FISCO Ltd. Analyst **Noboru Terashima**



FISCO Ltd.

<https://www.fisco.co.jp>

目次

■ 要約	01
1. 会社の沿革と主な事業内容	01
2. 2026年3月期の業績概要	01
3. 2027年3月期の業績予想	01
4. 中長期の展望：EV車の長航続距離化は追い風、新たにAI半導体向けが立ち上がる	02
■ 会社概要	03
1. 会社概要	03
2. 沿革	03
■ 事業概要	04
1. 主要事業	04
2. 製品別概要	06
3. 半導体業界の動向	07
4. 主な顧客と需要	09
5. 同社の生産能力と特許政策及び競合	09
■ 業績動向	10
1. 2026年3月期の業績概要	10
2. 財務状況	10
■ 今後の見通し	12
■ 中長期の展望	13
1. EV車の今後の課題（航続距離）と解決策	13
2. 潜在市場	14
3. もう1つの潜在市場（MOSFET用）とIGBTの広がり	14
4. AI半導体向け	15
■ 株主還元策	15

筑波精工

6596 東証 TOKYO PRO Market

2026年6月12日 (金)

<https://tsukubaseiko.co.jp/ir/>

要約

電気自動車 (EV車) の普及は追い風だが、足元は停滞。 新たにAI半導体向け需要が立ち上がる

筑波精工<6596>の主力事業は、電界による吸着保持技術を生かした静電吸着システム「静電チャック (E-Chuck)」(以下、静電チャック)の開発・製造・販売である。国際特許を保有する高度な技術だが、過去においてはあまり多くの需要が期待されていなかった。しかし、近年の自動車の電氣化 (EV化) に伴い、同社を取り巻く環境は変わりつつある。EV車の航続距離を延ばすために不可欠なパワー半導体の薄型化において、その製造工程で 사용되는同社の静電チャックに注目が集まったためだ。現在はまだ売上規模こそ小さいものの、EV化の進展や、2025年から立ち上がったAI半導体向けの新たな需要により、今後の動向が注目される。

1. 会社の沿革と主な事業内容

同社は、電気機械器具の製造販売並びに電気機械器具の検査、測定、治工具及び金型の販売を目的として、1985年に栃木県真岡市熊倉町で設立された。設立当初は三洋電機 (株) の半導体の後工程関係の設備を設計・販売していたが、並行して進めてきた静電チャックの開発に目途が付いたため、2002年より静電チャック事業に特化した体制へと舵を切った。その後、研究開発と関連製品の販売に注力し、2018年には東京証券取引所 TOKYO PRO Marketへ上場した。

2. 2026年3月期の業績概要

2026年3月期の業績は、売上高が278百万円 (前期比17.1%増)、営業損失が32百万円 (前期は44百万円の損失)、経常損失が32百万円 (同45百万円の損失)、当期純損失が49百万円 (同69百万円) となった。海外向け自動機ユニット及び「Supporter®」(以下、「Supporter」) の大口受注があったものの、計画していた先端 (AI) 半導体向け「Supporter」の売上が、客先でのテスト (評価) の遅れから次期以降にずれ込んだ。そのため売上高は前期比40百万円増にとどまり損益分岐点を下回った結果、営業損失を計上した。手元の現金及び預金は209百万円と売上規模に比べて豊富であり、当面の財務面に不安はない。純資産も現時点では137百万円となっているが、業績の停滞が長期化すれば債務超過に陥るリスクも否定できず、今後の動向には注視が必要である。

3. 2027年3月期の業績予想

2027年3月期の業績の見通しは、売上高が321百万円 (前期比15.6%増)、営業利益が4百万円 (前期は32百万円の損失)、経常利益が3百万円 (同32百万円の損失)、当期純利益が2百万円 (同49百万円の損失) となっている。EV向け需要は依然として停滞しているものの、中国の大手EVメーカーでは75 μ 以下の自社製IGBT生産工程において、同社製品のテストが継続されている。このほか、75 μ +12インチでの生産、8インチ向け「Supporter」需要、高速回転を行う欠陥検査装置向けなどでも同社製品のテストが進行中であり、これらが大規模な受注につながる可能性がある。ただし、現時点ではあくまで期待値であり確実な受注ではないため、今期の業績予想には算入されていない。そのため、現在の予想値は保守的な内容にとどまっている。

要約

4. 中長期の展望：EV車の長航続距離化は追い風、新たにAI半導体向けが立ち上がる

同社の今後の成長ドライバーは主に2つある。1つ目はEV車用IGBT半導体向けだが、これは当初見込みよりはやや停滞している。しかし今後、EV車ではさらなる長航続距離化が求められ、そのためには薄型IGBT※1 (パワー半導体) が必須であり、同社の「Supporter」の需要増につながる。顧客側は12インチプロセスの増強を進めているが、今のところ12インチの静電チャックでは、同社製品に対する競合は見当たらないため、12インチウエハによるパワー半導体の薄型シリコンウエハの生産が本格化すれば、同社製品への需要は本格的に立ち上がる可能性がある。2つ目は、携帯電話向けや自動車向けの高速バッテリーチャージャーやデータセンター等で使われるMOSFET※2半導体の生産工程においても同社製品が使われる可能性が高い。さらに最近では、AI半導体の歩留まり向上のために同社の静電チャック方式が着目されている。既に一部の顧客でテスト使用が行われており、今後本格受注につながるかが注目される。

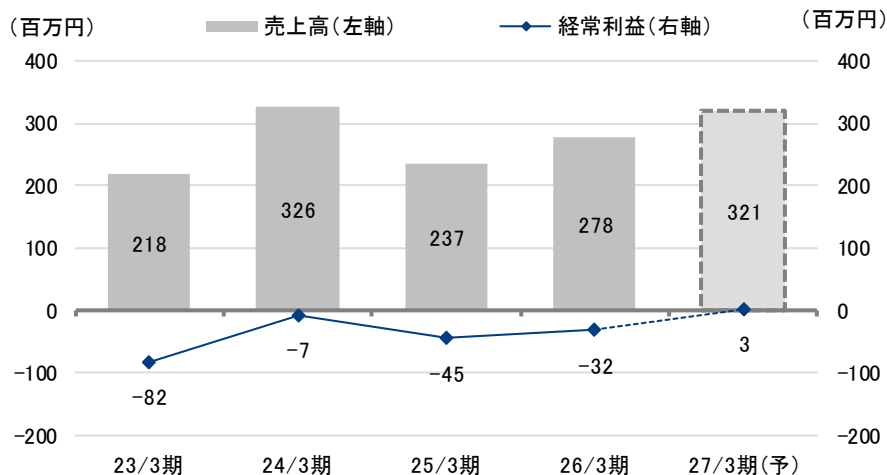
※1 IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor：絶縁ゲート型バイポーラトランジスタ) は、パワー半導体 (より高い電圧、より大きな電流のコントロールを可能にする) の一種である。用途としては、“電気で動き、パワーの強弱を調整できるもの”で、電車や自動車 (ハイブリッド車 (HEV) やEV)、IHをはじめとする家庭調理機器やエアコン、冷蔵庫、洗濯機などがある。

※2 MOSFET (Metal-Oxide-Semiconductor Field Effect Transistor：絶縁ゲート電界効果トランジスタ) は、スイッチデバイス的一种。スイッチデバイスは電源を入れることで様々な機能を動かすための装置へ電力を供給する。その際に、入力電圧を各所出力電圧へ変換して電力供給する必要がある。例えば、パソコンであれば、液晶パネル、CPU、メモリやオーディオアンプ、USBコネクタなどを動かすために、MOSFETが入力電圧を変換し、電力を供給する。スイッチデバイスのなかでもMOSFETは、電力を高効率に流し、低消費電力に優れ、製品の小型軽量化を可能にするものである。

Key Points

- ・電界を用いた吸着システム静電チャックの開発・製造・販売が主力事業。自動車のEV化で注目が集まる
- ・2026年3月期は案件のずれ込みで営業損失も、2027年3月期は業績回復を見込む
- ・中長期的には、EV車の長航続距離化の恩恵を受けるが、新たにAI半導体向けも立ち上がる

業績推移



出所：決算短信よりフィスコ作成

■ 会社概要

主力製品の静電チャック、EV・AI半導体領域で成長を見込む

1. 会社概要

同社は、静電チャックの開発・製造・販売を行う研究開発型の企業である。同社が自社開発した静電チャックの大きな特色は、対象物に電荷を与えることなく、低電圧で高吸着力を発生させる点にある。さらに、コードレスかつ薄型なCarrier型の静電チャック「Supporter」を実現したことも、強みとなっている。ウエハの極薄型化や微細化など技術の高度化により、他社の静電チャックでは対応が困難な分野において事業が拡大している。

近年はEVの出荷台数の増加により、車載用半導体 (IGBTやMOSFET) の薄型化が急激に進むと予想される。しかし、高性能化を目的として薄型化されたウエハの取り扱いが反りや割れの発生といった問題があるだけでなく、ウエハが大口径化する動きもあり、扱いが一段と難しくなっている。そうしたなか各半導体メーカーや台湾・中国のファウンドリ (半導体受託製造メーカー) において、同社の独自技術である「Supporter」が注目されている。この製品を用いることで、生産プロセスにおける薄型のウエハの取り扱いが容易となり、生産効率の向上と品質安定の両立が可能となる。

2. 沿革

同社は、電気機械器具の製造販売並びに電気機械器具の検査、測定、治工具及び金型の販売を目的として、1985年6月に栃木県真岡市熊倉町で設立された。当初は三洋電機の半導体の後工程を担う三洋シリコン電子 (株) の外販部門として後工程関係の設備を設計・販売していた。並行して社内で開発を進めてきた半導体やガラスなどの絶縁体の保持が可能な静電チャックの開発に目が付いたことから、2002年からは静電チャックの研究開発と静電チャック関連製品の販売に絞って事業を展開し、2018年に東京証券取引所TOKYO PRO Marketに上場した。

同社の代表取締役社長である傅寶葉 (ポー・フォライ) 氏は東京大学大学院工学系研究科樋口研究室にて静電界形成技術 (静電チャックの技術) を研究していた。当時の傅氏は同社から奨学金を得ており、卒業後すぐに同社に入社、以後も静電チャックの研究・開発を続け、同社をけん引している。

静電チャックの技術は、従来は吸着不可能とされてきた素材 (半導体や絶縁体など) への吸着を可能としたが、当初はフラットパネルディスプレイのガラスの吸着テーブルなどに需要に限られていた。しかし2010年代に入り、EV向けインバータの中心部品である次世代低抵抗IGBT、5G通信基地局向け半導体等のパワー半導体市場が拡大し、同市場向け半導体ではウエハ薄型化後の裏面のプロセスの安定化が重要な課題となった。「Supporter」は、ウエハ裏面プロセスにおいて、薄型ウエハを安定保持するためのウエハキャリアとして機能する。

会社概要

沿革

年月	事項
1985年 6月	栃木県真岡市熊倉町にて資本金200万円で株式会社設立
1988年 7月	栃木県真岡市松山町に移転
2002年 4月	静電チャックの設計販売開始
2003年 4月	液晶生産装置ODF向けG4、G5基板対応静電チャックの設計販売開始
2004年 6月	ODF向けG6、G7基板対応静電チャックの設計販売開始
2006年 9月	本社を栃木県河内郡上三川町に移転 関東経済局より「異分野連携新事業分野開拓計画」の認定を受ける
2007年 8月	ODF向けG8基板対応静電チャックの設計販売開始
2009年 4月	経済産業省の「2009元気なモノ作り中小企業300社」に選定
2013年 6月	Carrier (キャリア) 型静電チャック「Supporter®」販売開始
2018年11月	東京証券取引所TOKYO PRO Marketに上場

出所：発行者情報よりフィスコ作成

事業概要

「ステージ」「Supporter」「自動機」の3製品を製造。 根幹技術は静電チャック

1. 主要事業

(1) 静電チャックとは

静電チャックとは、特定の素材基板（保持材）表面に電界を発生させることで、対象物（ガラスやシリコンウエハなど）を吸着保持する“治具（保持具）”のことである。対象物が非常に軽い・薄い素材の場合には割れやすく、あるいは反ってしまうことが多いため、長時間にわたって移動を繰り返すことは容易ではない。対象物が各種の製造プロセスを移動するような場合（例えばシリコンウエハなど）には、対象物を頑丈な治具に吸着保持させることで反りや割れといった損傷を防げる。

事業概要

(2) 特色と強み

静電チャックの技術そのものは古くから存在し、様々な分野で使われているが、同社の静電チャックは以下のような特色がある。

1) 対象物が多様

同社の静電チャックの第一の特色は、対象物表面に電界を集中させることで、低電圧で高吸着力を発生させることにある。そのため、既存の静電チャックでは取り扱えなかったガラス・紙などの絶縁体の素材や極薄ウエハ等の半導体分野でも利用できる。

2) 吸着力が均一で強い

電界の表面集中とイオン分極の最適化により、吸着が均一で吸着力が相対的に強い。この吸着力が均一であることが、下記に述べるようにAI半導体 (正確には超微細化加工が必要な半導体) 向けに評価されている。

3) 給電ユニットなしで吸着力を維持

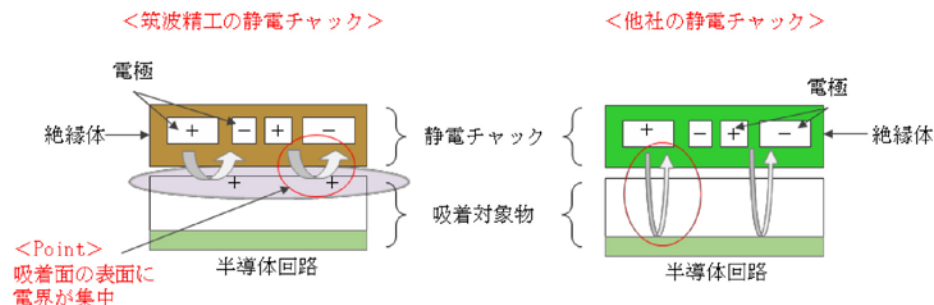
一般的な静電チャックが給電ユニットを常時接続して吸着力を維持するのに対して、同社の静電チャックは給電ユニットを外しても吸着力を維持できる点が特色である。また、回路形成後のシリコンウエハだけでなく、将来的にはパワー半導体等向けとして有望視されるガリウムひ素、チツ化ガリウム、セラミック等にも応用可能になると見られる。なお、同社製品のなかで、給電ユニットなしでも吸着を維持できる製品は「Supporter」である。

同社製品と既存製品の特色比較1

比較項目	同社の静電チャック	既存の静電チャック
静電チャックの基礎技術	独自で開発した電極と絶縁層の最適化設計技術により電界を吸着物の表面に集中発生させ、吸着物の表面を最大限にイオン分極させることで強い吸着力を得られる	電界の制御ができず、吸着物の表面に電界が集中しない。高電気抵抗体の吸着物の表面をイオン分極できないため吸着力が弱くなる
コードレスで薄いCarrier型静電チャック	独自開発した電界の貯蔵技術で、吸着物吸着後、外部電源を外しても半永久に吸着力を維持できる。かつ、厚みが0.5mmと薄く	対象物を分極吸着できるCarrier型静電チャックはない
静電チャック	既存設備の変更不要で極薄ウエハプロセスを可能にする	

出所：発行者情報よりフィスコ作成

同社製品と既存製品の特色比較2



出所：発行者情報より掲載

事業概要

2. 製品別概要

従来は、主たる製品である「Supporter」及び「ステージ(ディスプレイ向け)」とそれ以外の「その他(ディスプレイ向け以外のステージ類似製品)」を製品別の区分としていたが、2024年3月期より給電ユニットから分離しても単体で稼働する静電チャックシステムの売上を「Supporter」、給電ユニットに常時接続して稼働する静電チャックシステムの売上を「ステージ」としている。また、今後は自動機ユニットの販売の重要性が増すと予想されるため、「自動機」の分類を新たに設けた。

(1) 「ステージ」

給電ユニットが付属している静電チャックを、“システム”として販売している。対象物の吸着/分離をコントロールできることから、薄いガラス板、スマートフォンのディスプレイ用フィルム、大型ディスプレイのODF(液晶滴下方式工法)向けとなっている。顧客は、スマートフォンを生産するメーカーに部品を納入しているメーカーや、大画面(2m×2mなど)の液晶ディスプレイを扱うメーカーなどである。

(2) 「Supporter」

主力製品である“静電チャック”の一種で、ガラスの両面に特殊な素材を挟みこみ一体形成したものである。同社既存の静電チャックが持つ特色に加え、給電ユニットから分離しても吸着力を維持する特色を備えている。給電ユニットを用いて一度電界をかけると保持力は半永久的に維持され、もう一度給電ユニットを用いて電界を解除すれば、いつでも「Supporter」と対象物を分離できるという従来の静電チャックにはなかった特色を有しており、“常識を打ち破った製品”と言える。「Supporter」は、半導体の製造プロセスでウエハの把持、運搬などに利用されるが、既存の製造ラインに大幅な修正を加えずに50 μ 厚(μ = 1,000分の1mm)などの薄型ウエハの製造プロセスで発生するウエハの反りや微細なクラックによる不良品の発生を防止し、製造ラインの自動化率と製品の歩留率を向上させる。同製品の売上高は、主に「Supporter」の販売枚数×価格(非開示)である。

「Supporter」の特長を要約すると次のようになる。

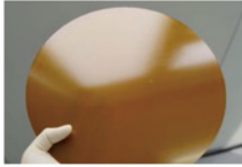
- ・ 0.5mm厚と薄いため、半導体ラインにそのまま投入可能
- ・ ウエハ吸着後も外部給電を必要としない
- ・ 給電ユニットから分離しても吸着力は半永久的に持続
- ・ 薄型ウエハの加工を可能とするほか、クラック等の発生を防止して歩留まりの向上を実現

(3) 「自動機」

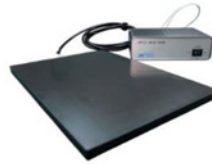
「Supporter」に電界をかけて半導体製造ラインに自動投入するための機器を指す。2023年3月期までは試験用の半自動機であったが、2024年3月期に量産ライン用の「自動機」の販売を開始したため、新たな分類を設けた。

事業概要

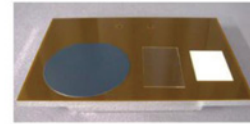
製品一覧



**Supporter (サポーター)
システム**



ESCステージ (生産設備向け)

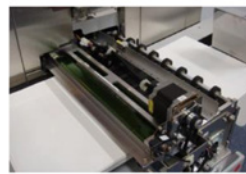


コードレスホルダー



ハンディタイプ (ソフトバーム)

出所：同社ホームページより掲載



静電ベルト



ウエハーハンド

3. 半導体業界の動向

(1) 半導体製造プロセス

一般的にメーカーが半導体 (ICチップ) を製造するプロセスは、まずシリコンインゴットを薄く切りウエハを作成する。この時点でウエハの厚さは約700 μ あるが、この表面に真空蒸着、エッチング、アニーリング、スパッタリング、イオン注入などの方法で回路を形成する。パワー半導体に特徴的なプロセスとして、回路側の面に保護用のテープを貼付し、裏面を研磨して100~150 μ まで薄くした後に、さらに裏面へのイオン注入やアニールなどの工程が必要となる。これらの工程を何度も繰り返してようやく1枚のウエハの回路作成が完了するため、回路作成には通常は6~10日ほど、複雑な回路では1ヶ月近くかかる場合もある。

この間、ウエハは真空状態や高温のプロセスなどを何度も繰り返し移動するが、裏面研磨後のウエハは非常に薄く、回路形成によるストレス蓄積等のため反りや割れといった損傷が発生しやすい。そのため回路生成プロセスにおいては、ウエハの表面 (表面の回路が形成された面) に保持材を貼り補強してから裏面の回路形成プロセス間を移動させて、回路裏面の回路形成が終了した後、最終的にこの保持材を分離する。従来は、この裏面保持の方法として保持材を接着剤で貼り付けて補強するのが一般的であったが、今後自動車分野でのパワー半導体 (IGBT等) の需要が高まればウエハはさらなる薄型化と大口径化が進むと予想されている。接着剤方式では薄型化 (100 μ 以下) と大口径化 (12インチ) への対応が難しいと業界では見られている。

筑波精工

2026年6月12日 (金)

6596 東証 TOKYO PRO Market

<https://tsukubaseiko.co.jp/ir/>

事業概要

(2) 自動車向け半導体

近年自動車のEV化が急速に進んでいる。自動車のEV化にとって半導体の安定的な供給体制の確保は極めて重要な要素の1つに位置付けられている。特に動力(パワー)部分では、バッテリーから出た電気(DC=直流)をモーターで使用する交流(AC)に高速で変えるインバータが不可欠な基幹部品となる。インバータ用の半導体(IGBT)では、径を大きくすることで1枚のウエハからより多くの半導体を作成できるため生産効率が上がり、1個当たりのコストを下げられる。しかし大容量(高アンペア)かつ高電圧(高ボルト)で表面と裏面の間でスイッチングを高速で繰り返すため、ウエハが厚い状態では発熱量*が増えることから、発熱の原因となるオン抵抗値をできる限り小さくするためウエハを薄型化する必要がある。半導体メーカーは、発熱量の点から半導体をできるだけ薄いウエハで生産し、かつ生産効率の点から大口径のウエハでの生産を目指している。

* インバータに使われるIGBTやMOSFETが発熱すると、EVのエネルギー効率が低下する。

(3) 半導体の薄型化と静電チャック

IGBTの生産プロセスでは、ウエハの薄型化がさらに進むという見方もある。さらに、多くのメーカーが生産効率の点から12インチ(300mm)ウエハへ移行する可能性が高い。その結果、ウエハはより薄く大きくなるため、反りや割れといった損壊のリスクが一段と高まる。それを避けるために保持材の貼付が必須となるが、従来の接着剤方式ではプロセスのなかで溶剤がガス化して半導体を汚染するリスクがある。また、保持剤を取り外す際にウエハが破損するリスクが高まるなど難点が多いと言われている。

そこで注目されているのが、同社が提供する静電チャック(方式)である。前述のとおり、同社の製品は一度電界をかけると半永久的に吸着保持を維持し、真空・高温などの環境下でも保持力が落ちないため、薄型化・大口径化されたウエハに対して最適な製品と言える。

(4) 半導体の微細化と静電チャック

もう1つの半導体業界の動向としては「微細化」が挙げられる。特にAI半導体などで超微細化が進んでいるが、現状ではプロセス装置や検査装置内のウエハ吸着固定による極微細な接触傷が歩留まりを低下させている。このため、キャリア(Carrier)でウエハをソフト吸着固定し、キャリアを固定することで間接的にウエハを固定する方法が歩留まり向上のために有効である。例えば5nmパターン以下では、「Supporter」(Carrier)を使えばウエハを全面でソフト吸着するため、ウエハ面積当たり作用する吸着応力が大きく低下する。従来のメカクランプ等による集中応力によって起こされる局所的なウエハ接触傷を減らすことで、結果として歩留まりの向上につながる。その上、「Supporter」吸着面は半導体ウエハに比べて柔らかいPI樹脂で形成されているため、相対的に硬い半導体ウエハ面を傷付けにくい。

またEV向け半導体では、「ウエハの薄型化」が最重要課題であったが、AI半導体向けでは「欠陥検査時における接触傷の減少による歩留まり向上」が重要な課題となっている。現在の方法では、ウエハを高速回転して欠陥検査を行うが、この時に接触傷が生じることが問題となっている。しかし同社の「Supporter」を使うことで接触傷を大きく減らすことが可能になり、大手のファウンドリにおいて実用化に向けた評価・テスト検査が進められている。

事業概要

4. 主な顧客と需要

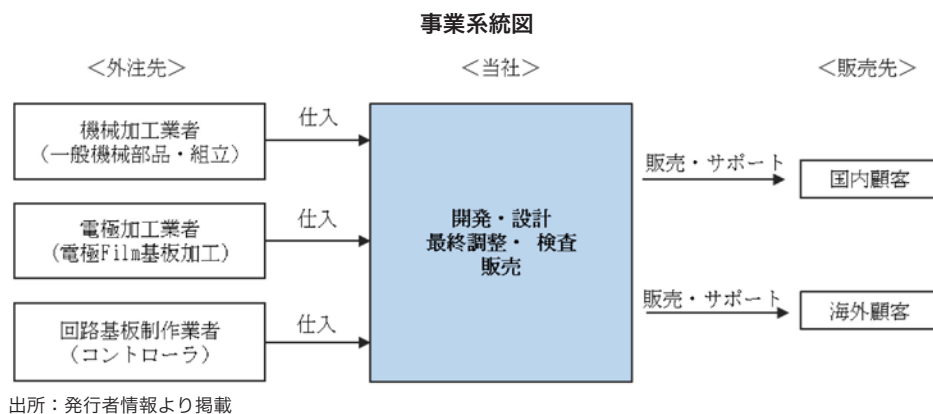
同社の主力製品である「Supporter」の主要顧客は半導体のデバイスメーカーであり、その需要規模は生産されるウエハの枚数に比例する。「Supporter」は1枚のウエハが一通りの製造プロセスを終了した後に取り外し、洗浄工程を経ることで再利用が可能となる。したがって、仮に一通りの製造プロセスを終了するのに6日を要すると想定した場合、1枚の「Supporter」は月に5回の回転(利用)が可能となる。このため、顧客企業が必要とする保有枚数は、月間ウエハ生産能力の5分の1程度と試算される。具体的には、月産5万枚の生産能力を有するラインにおいては、1万枚の「Supporter」が必要となる計算となる。なお、製品の絶対寿命は約2年間とされており、一定期間ごとのリプレース需要も安定的に発生する見通しである。

同社の主要顧客の詳細は非開示となっているが、技術動向の観点からその構成を推察することが可能である。同社によれば、IGBTの表面パターン(回路生成)に関する特許網は米国および日本企業が強固に保持しており、この領域において中国メーカーは後塵を拝している。こうした背景から、中国メーカーは表面プロセスでの競合を避け、薄型化技術を中核とする裏面プロセス分野へ重点的な投資を行っている。その結果、裏面プロセスにおける生産効率化を支援する同社製品への引き合いも、中国や台湾のメーカーが多いようだ。同社による公開資料「中間発行者情報」に記載された2026年3月期第2四半期の販売先別実績の上位は、KUNSHAN KODIT PRECISION INDUSTRY CO.,LTD.(中国)、売上高64百万円(売上高比率52.8%)となっている。

5. 同社の生産能力と特許政策及び競合

同社製品の生産については、一部を内製し、その他の部分を数ヶ所に分けて外注する「ファブライト」方式を採用している。各外注先には工程を断片化して発注しているため、外部からは最終製品の全容が把握しにくい構造となっている。また、本製品は大規模な生産設備を必要としない特性を有しており、急激な需要増大に対しても柔軟に対応可能である。同社も「生産が間に合わない事態にはならない」との見解を示している。

知的財産の保護戦略においても、外注の分散と同様に高度な秘匿性が確保されている。同社は広範な特許ポートフォリオを構築している一方で、すべての技術・ノウハウを特許申請しているわけではない。あえて権利化せずブラックボックス化(秘匿化)することで、競合他社によるリバースエンジニアリングや盗用を困難にしており、類似製品の台頭に対する参入障壁を築いている。



業績動向

2026年3月期はEV停滞で営業損失も、期末にかけて回復の気配

1. 2026年3月期の業績概要

2026年3月期の業績は、売上高が278百万円（前期比17.1%増）、営業損失が32百万円（前期は44百万円の損失）、経常損失が32百万円（同45百万円の損失）、当期純損失が49百万円（同69百万円）となった。海外向け自動機ユニット及び「Supporter」の大口受注があったものの、計画していた先端半導体（AI）向け「Supporter」の売上が、客先でのテスト（評価）の遅れから次期以降にずれ込んだ。そのため売上高は前期比40百万円増にとどまり損益分岐点を下回った結果、営業損失を計上した。

製品別売上高は、「ステージ」が172百万円（前期比4.5%減）、「Supporter」が52百万円（同8.1%減）、「自動機」は53百万円（前期は売上計上なし）であった。「ステージ」については、量産前案件が進行していたが、予定より約半年遅れたことなどから、売上高は微減となった。「Supporter」においても、先端半導体（AI）向けが客先でのテスト（評価）の遅れにより、約60百万円が次期以降にずれ込んだことから前期比で減収となった。

2026年3月期の業績

（単位：百万円）

	25/3期		26/3期		前期比	
	金額	売上比	実績	売上比	増減額	増減率
売上高	237	-	278	-	40	17.1%
ステージ	180	76.0%	172	62.0%	-8	-4.5%
サポーター	57	24.0%	52	18.9%	-4	-8.1%
自動機	0	-	53	19.1%	53	-
売上総利益	133	56.1%	156	56.0%	22	17.0%
販管費	177	74.8%	188	67.8%	10	6.0%
営業利益	-44	-	-32	-	12	-
経常利益	-45	-	-32	-	13	-
当期純利益	-69	-	-49	-	20	-

出所：決算短信よりフィスコ作成

自己資本比率は53.1%と財務基盤は堅守、早期の黒字転換が急務に

2. 財務状況

2026年3月期末の資産合計は前期末比73百万円減の259百万円となった。流動資産は同73百万円減の256百万円となった。主に現金及び預金の減少69百万円、売掛債権の増加1百万円、棚卸資産の減少5百万円による。固定資産は、同0.5百万円減の2百万円であった。

業績動向

流動負債は同4百万円減の46百万円となった。主な変動要因は、電子記録債務が7百万円減少、未払法人税等が5百万円減少、1年内返済予定の長期借入金が10百万円増加したことによる。固定負債は同19百万円減の75百万円となったが、主に長期借入金が22百万円減少したことによる。この結果、負債合計は同24百万円減の121百万円となった。

純資産については、資本の組み換えを行っており、資本金が817百万円減、資本準備金が857百万円減少し、その他資本準備金に振り替えられた。純資産合計は同49百万円減の137百万円となった。2026年3月期末の自己資本比率は53.1% (前期末56.2%) となり、現金及び預金は209百万円で、現時点では問題ない水準だが、今後も損失計上が続くようであれば、債務超過に陥るリスクも否定できず、今後の財務状況は注視が必要である。

2026年3月期の営業活動によるキャッシュ・フローは45百万円の支出となった。主なプラス要因としては、減損損失8百万円、貸倒損失8百万円、棚卸資産の減少5百万円などで、主な支出要因は税引前当期純損失48百万円、売上債権の増加3百万円、仕入債務の減少6百万円などであった。投資活動によるキャッシュ・フローは有形固定資産の取得に伴い10百万円の支出となった。財務活動によるキャッシュ・フローは長期借入金の返済により12百万円の支出となった。この結果、現金及び現金同等物の期末残高は、前期末比69百万円減少し、149百万円となった。

貸借対照表

(単位：百万円)

	25/3期末	26/3期末	増減額
流動資産	329	256	-73
現金及び預金	278	209	-69
売掛債権 (電子記録債権含む)	16	17	1
棚卸資産	18	13	-5
固定資産	3	2	-0
資産合計	332	259	-73
流動負債	51	46	-4
仕入債務 (電子記録債権含む)	11	4	-6
未払法人税等	5	0	-5
固定負債	94	75	-19
長期借入金	90	67	-22
負債合計	145	121	-24
純資産合計	186	137	-49

出所：決算短信よりフィスコ作成

キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	25/3期	26/3期
営業活動によるキャッシュ・フロー	-58	-45
投資活動によるキャッシュ・フロー	-1	-10
財務活動によるキャッシュ・フロー	-13	-12
現金及び現金同等物の増減額	-73	-69
現金及び現金同等物の期末残高	218	149

出所：決算短信よりフィスコ作成

■ 今後の見通し

2027年3月期は営業黒字を目指す。 EV向け回復に加えてAI半導体向けに期待

2027年3月期の業績は、売上高が321百万円（前期比15.4増）、営業利益4百万円（前期は32百万円の損失）、経常利益3百万円（同32百万円の損失）、当期純利益2百万円（同49百万円の損失）の見通しである。

2027年3月期の業績見通し

（単位：百万円）

	26/3期		27/3期(予)		前期比	
	金額	売上比	予想	売上比	増減額	増減率
売上高	278	-	321	-	43	15.4%
営業利益	-32	-	4	1.2%	36	-
経常利益	-32	-	3	0.9%	35	-
当期純利益	-49	-	2	0.6%	51	-

出所：決算短信よりフィスコ作成

製品別の売上高予想は非開示とされているものの、各製品ラインにおいて需要の拡大が見込まれている。同社によれば、現在、収益基盤を押し上げる可能性のある3つの有力な案件が進行中である。1つ目に、EV市場向けとして、75 μ +12インチの薄型化プロセスに対応した自動機の出荷が既に完了しており、今後は量産フェーズへの移行による本格的な収益貢献が期待される。2つ目に、既存の8インチでの「Supporter」の追加注文が実行される蓋然性が高まっている。そして3つ目に、ウエハの検査工程における採用である。前述の通り、前期より大手ファウンドリによる実証テストが継続しており、これに呼応する形で、足元では検査装置メーカーからも引き合いが生じ始めている。同社は、これらの案件は現時点で確定事項ではないため今期予想には反映させていないとしつつも、テストの進捗次第では今期業績への上乗せ要因となり得る旨を示唆している。次世代プロセスへの適応加速を含め、同社の成長性を占う上で今後の動向が注目される。

■ 中長期の展望

EV車の課題は「長航続距離」、 AI半導体の歩留まり向上には「Supporter」が有効

1. EV車の今後の課題（航続距離）と解決策

過去数年間、中国と欧米を中心に自動車のEV化は加速度的に進んだが、足元ではその伸び率が鈍化している。この背景として指摘される主要な課題の一つが「航続距離」、すなわち1回の充電で走行可能な距離の制約である。特に冬季においては、車内暖房による電力消費が大幅に増大し、その結果充電ステーションにおける待機時間の増大や長蛇の列といった利便性の欠如が顕在化しており、消費者の「EV離れ」を誘発する一因となっている。

(1) EV車の長航続距離化にはインバータの発熱減が必須

EV車（大衆車）の欠点の1つとして、航続距離が短いことが挙げられているが、長距離化走行を実現するためには、主に2つの点の改善が必要である。1つ目はバッテリー（蓄電池）の大容量化であり、これはガソリン車で言えば燃料タンクを大きくすることに相当する。2つ目は、電気の変換効率を上げることで、ガソリン車で言えば燃費性能を改善することになる。変換効率を左右する要因は、インバータの発熱にある。EV車では、バッテリーのDC電力をACに変換しモーターを回すが、この役割を果たすのがインバータで、変換時の発熱が電力損失を生んでいる。今後EV車の航続距離を伸ばすためには、インバータでの電力損失を極力抑えることが必須条件となる。

(2) 2つの解決策：SiC基板か極薄Si基板

同社によれば、このインバータでの熱損失を抑える方法は、現時点においては主に2つあるとのこと。1つはSiC（シリコンカーバイド）基板を使うことだが、SiC基板は量的な供給が限られていることから非常に高額であり、限られた一部の高級車にのみ搭載できる。一般大衆車への搭載はコスト面から難しい。一方でSi基板（通常のシリコンウエハ）は安価で大量供給が可能だが、熱損失を抑えるためには厚みを80 μ m厚（可能なら60 μ m厚）以下にする必要がある。しかし量産ラインにおいては80 μ m厚以下のウエハの取り扱いが非常に難しく、通常の「接着剤方式」が使えないため、同社の「静電チャック方式」が必要となる。

注：上記は取材に基づいた同社の説明による。

2. 潜在市場

上述のような事業環境を鑑みると、同社の将来性には期待すべき側面があるものの、ウエハの薄型化には克服すべき課題や障壁も依然として多い。同社は当初、EV向けウエハの薄型化進展を2024年3月期以降と見込んでいたが、実際は2~3年程度の遅れが生じている状況にある。こうした状況を踏まえると、同社の業績が本格的な回復および拡大基調に転じるのは、2027年3月期以降になるものと予想される。

今後の潜在市場の規模について、同社によれば、従来、薄型IGBT生産の主流は6インチウエハであったが、2023年秋からは8インチウエハで80 μ が本格稼働しており、さらに一部では12インチウエハへの移行が始まりつつある。12インチウエハ1枚からは自動車約3台分のIGBTが取れると言う。したがって今後のEV自動車生産予測から、同社では12インチウエハ用「Supporter」の需要については、遅くとも2028年3月期に7,000枚/年になると見ているようだ。

「Supporter」の価格は正式には開示されていないが、取材に対して同社は「12インチウエハ用で1枚数千米ドルのレベル」と述べている。仮にこの価格を3千ドル、1米ドルを150円とすると、2028年3月期の「Supporter」の売上高は、 $7,000 \times 3,000 \times 150 = 3,150$ 百万円※となる可能性がある。

※ これらの数字は弊社推測によるもので、同社から正式に発表された数字ではない。

同社によれば、既に12インチ月産15万枚を準備している顧客がいるとのことで、事実2024年3月期には12インチ量産用の「自動機」を販売した。同社では12インチの保持材について、今のところ「Supporter」に対して競合する製品はないと見ている。今後は8インチでの同社製品の採用が増加するとともに、12インチへの展開も注視する必要がある。

3. もう一つの潜在市場 (MOSFET用) とIGBTの広がり

同社製品(主に「Supporter」)に対して、もう一つ大きな市場として期待されるのがMOSFET用だ。現在、自動車用と携帯電話用バッテリーの大容量化が進んでおり、これらのバッテリーにおいては高速(短時間)での充電が求められている。そのため、高電圧をかける必要があり、これに耐えられるMOSFET半導体が必須部品となる。MOSFET半導体の厚さは約100 μ であるが、デバイスメーカーとしては少しでも生産効率を上げるために8インチウエハでの生産を標準としている。その生産工程ではウエハの「反り」が大きな問題となるが、これに対応できるのが同社の「Supporter」である。

同社ではMOSFET用としての「Supporter」の需要も今後増えていくと見ており、IGBT用と並び注目したい市場である。MOSFET用(8インチ用)の価格は、IGBT用(12インチ用)よりは低いと予想されるが、将来の売上高は年間200~300百万円に上る可能性があるとして弊社では見ている。

また最近では、薄型IGBT市場が広がってきている点にも注目したい。現在、最も需要が期待されているのがEVであるのは言うまでもないが、近年では風力発電用、家電用にも需要が広がっている。

筑波精工

6596 東証 TOKYO PRO Market

2026年6月12日 (金)

<https://tsukubaseiko.co.jp/ir/>

中長期の展望

4. AI半導体向け

今後の成長が期待される市場はAI半導体向け、より厳密には「超微細化の半導体向け」の領域である。AI半導体などでは超微細化が進んでいるが、現状ではプロセス装置や検査装置内のウエハ吸着固定による極微細な接触傷が歩留まりを大きく低下させており、これを改善するために、同社の「Supporter」(Carrier)の採用が検討されている。既に海外大手のファウンドリ向けにテストライン用の受注があったが、今後は検査装置メーカーでのテストを経て量産ラインに採用されれば大きな受注が期待できる。EV向けに加えて、今後はAI半導体向けも注視したい。

■ 株主還元策

収益基盤の確立を優先

株主還元については、同社が依然として発展途上の段階にあり、十分な余剰利益を確保するには至っていない。現時点での還元実施は時期尚早であり、まずは足元の収益力を強化し、安定した利益成長を軌道に乗せることが最優先課題である。

重要事項 (ディスクレマー)

株式会社フィスコ(以下「フィスコ」という)は株価情報および指数情報の利用について東京証券取引所・大阪取引所・日本経済新聞社の承諾のもと提供しています。本レポートは、あくまで情報提供を目的としたものであり、投資その他の行為および行動を勧誘するものではありません。

本レポートはフィスコが信頼できると判断した情報をもとにフィスコが作成・表示したのですが、フィスコは本レポートの内容および当該情報の正確性、完全性、的確性、信頼性等について、いかなる保証をするものではありません。

本レポートは、対象となる企業の依頼に基づき、企業への電話取材等を通じて当該企業より情報提供を受け、企業から報酬を受け取って作成されています。本レポートに含まれる仮説や結論その他全ての内容はフィスコの分析によるものです。

本レポートに掲載されている発行体の有価証券、通貨、商品、有価証券その他の金融商品は、企業の活動内容、経済政策や世界情勢などの影響により、その価値を増大または減少することもあり、価値を失う場合があります。本レポートは将来のいかなる結果をお約束するものでもありません。お客様が本レポートおよび本レポートに記載の情報をいかなる目的で使用する場合においても、お客様の判断と責任において使用するものであり、使用の結果として、お客様になんらかの損害が発生した場合でも、フィスコは、理由のいかなを問わず、いかなる責任も負いません。

本レポートに記載された内容は、本レポート作成時点におけるものであり、予告なく変更される場合があります。フィスコは本レポートを更新する義務を負いません。

本文およびデータ等の著作権を含む知的所有権はフィスコに帰属し、フィスコに無断で本レポートおよびその複製物を修正・加工、複製、送信、配布等することは強く禁じられています。

フィスコおよび関連会社ならびにそれらの取締役、役員、従業員は、本レポートに掲載されている金融商品または発行体の証券について、売買等の取引、保有を行っているまたは行う場合があります。

以上の点をご了承の上、ご利用ください。

■お問い合わせ■

〒107-0062東京都港区南青山5-13-3

株式会社フィスコ

電話：03-5774-2443 (IRコンサルティング事業本部)

メールアドレス：support@fisco.co.jp